

Dell EMC PowerEdge C6520

仕様詳細

メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

章 1: 仕様詳細	4
スレッドの寸法.....	4
シャーシの重量.....	5
プロセッサの仕様.....	5
PSU の仕様.....	5
対応オペレーティング システム.....	5
システムバッテリーの仕様.....	6
拡張カードライザーの仕様.....	6
メモリーの仕様.....	6
ドライブ.....	7
ストレージの仕様.....	7
ポートおよびコネクタの仕様.....	8
USB ポートの仕様.....	8
ディスプレイ ポートの仕様.....	8
NIC ポートの仕様.....	8
iDRAC9 ポートの仕様.....	8
ビデオの仕様.....	8
環境仕様.....	9
粒子状およびガス状汚染物質の仕様.....	10
温度制限.....	10

仕様詳細

本項では、お使いのシステムの仕様詳細と環境仕様の概要を示します。

トピック：

- スレッドの寸法
- シャーシの重量
- プロセッサの仕様
- PSU の仕様
- 対応オペレーティング システム
- システムバッテリーの仕様
- 拡張カードライザーの仕様
- メモリーの仕様
- ドライブ
- ストレージの仕様
- ポートおよびコネクタの仕様
- ビデオの仕様
- 環境仕様

スレッドの寸法

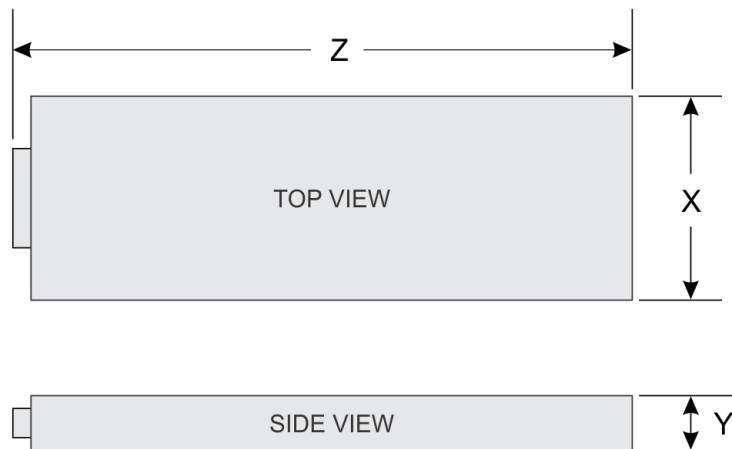


図 1. スレッドの寸法

表 1. PowerEdge C6520 のスレッドの寸法

X	Y	Z
447.04 mm (17.6 インチ)	86.36 mm (3.4 インチ)	802.64 mm (31.6 インチ)

シャーシの重量

表 2. PowerEdge C6520 のスレッドを搭載したエンクロージャのシャーシ重量

システム設定	最大重量 (すべてのスレッドおよびドライブ)
12 x 3.5 インチ	45.6 kg (100.53 lb)
24 x 2.5 インチ	41.4 kg (91.27 lb)
バックプレーンなしのシステム	35 kg (77.16 lb)

プロセッサの仕様

表 3. PowerEdge C6520 プロセッサの仕様

サポートされるプロセッサ	サポートされているプロセッサ数
第 3 世代 インテル Xeon スケーラブル プロセッサ ((最大 40 コア))	2

PSU の仕様

PowerEdge C6520 システムは、最大 2 台の AC 電源供給ユニット (PSU) をサポートします。

表 4. PSU の仕様

PSU	クラス	熱消費 (最大)	周波数	電圧	AC		現在
					高ライン	低圧線 100 ~ 120 V	
2600 W	プラチナ プラチナ	9750 BTU/時	50/60 Hz	100 ~ 240 V オートレンジ	2600 W (220 ~ 240 V)	1400 W	16 A
2400 W	プラチナ	9000 BTU/時	50/60 Hz	100 ~ 240 V オートレンジ	2400 W (200 ~ 240 V)	1400 W	16 A
2000 W	プラチナ	7500 BTU/時	50/60 Hz	100 ~ 240 V オートレンジ	2000 W (200 ~ 240 V)	1000 W	11.5 A
1600 W	プラチナ	6000 BTU/時	50/60 Hz	100 ~ 240 V オートレンジ	1600 W (200 ~ 240 V)	800 W	10 A

① **メモ:** パーツ ナンバー 9D4R6 を搭載した 2600 W PSU では、C14 ~ C19 アダプター コードのみがサポートされます。

① **メモ:** このシステムは、相間電圧が 240 V 以下の IT 電力システムに接続できるようにも設計されています。

① **メモ:** 熱消費は PSU のワット定格を使用して算出されています。

① **メモ:** システム構成を選択またはアップグレードする場合は、最適な電力使用率を達成できるように、[Dell.com/ESSA] で入手できる Dell Energy Smart Solution Advisor でシステムの電力消費量を検証します。

対応オペレーティング システム

PowerEdge C6520 システムでは、次のオペレーティング システムがサポートされています。

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Hypervisor
- Hyper-V 搭載 Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux

- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi/vSAN
- CentOS
- Windows プレイインストール環境 (WinPE) 64 ビット ドライバー

詳細については、 www.dell.com/ossupport を参照してください。

システムバッテリーの仕様

PowerEdge C6520 システムは、 CR 2032 3.0 V コイン型リチウム電池システム バッテリーをサポートします。

拡張カードライザーの仕様

PowerEdge C6520 システムは、最大 4 個の PCI express (PCIe) Gen 4 拡張カードをサポートします。

表 5. システム ボードで使用できる拡張カード スロット

PCIe スロット	ライザー	ライザーの幅	PCIe スロットの高さ	PCIe スロットの長さ	PCIe スロットの幅
スロット 1	ライザー 1a	x16 PCIe	ロープロファイル	ハーフ レングス	x8
スロット 1	ライザー 1bSNAPI/O モジュールをサポートするライザー 1b	x16 PCIe	ロープロファイル	ハーフ レングス	x8 + x8
スロット 2	ライザー 2b	x16 PCIe	ロープロファイル	ハーフ レングス	x8

① **メモ:** 拡張カードの取り付けガイドラインについては、システム固有の <https://www.dell.com/poweredgemanuals> から入手可能な『設置およびサービス マニュアル』を参照してください

メモリーの仕様

PowerEdge C6520 システムは、作動を最適化するために次のメモリー仕様をサポートしています。

表 6. メモリーの仕様

DIMM のタイプ	DIMM のランク	DIMM の容量	シングルプロセッサ		デュアルプロセッサ	
			最低システム容量	最大システム容量	最低システム容量	最大システム容量
RDIMM	シングルランク	8 GB	8 GB	64 GB	16 GB	128 GB
	デュアルランク	16 GB	16 GB	128 GB	32 GB	256 GB
		32 GB	32 GB	256 GB	64 GB	512 GB
		64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1 TB
LRDIMM	クワッドランク	64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1 TB
		128 GB	128 GB	1 TB	256 GB	2 TB

表 7. メモリモジュールソケット

メモリモジュールソケット	速度
288 ピン (16)	3200 MT/s、2933 MT/s、2666 MT/秒

ドライブ

PowerEdge C6520 システムは、次をサポートしています。

- 12 x 3.5 インチ SAS/SATA (HDD/SSD) ドライブ
- 24 x 2.5 インチ SAS/SATA (HDD/SSD)、または NVMe

表 8. PowerEdge C6520 スレッドでサポートされているドライブ オプションの最大数

スレッド内のドライブの最大数	スレッドごとに割り当てられたドライブの最大数
12 x 3.5 インチドライブ システム	スレッドあたり 3 台の SAS または SATA ドライブと SATA SSD
24 x 2.5 インチ非 NVMe ドライブ構成	スレッドあたりの 6 台の SAS または SATA ドライブとは SATA SSD
8 x 2.5 インチ NVMe ドライブ構成 スレッドあたり 2 台の NVMe ドライブ/シャーシあたり 8 台の NVMe ドライブ)	NVMe バックプレーンは、次のいずれかの構成をサポートします。 <ul style="list-style-type: none"> • スレッドあたり 2 台の NVMe ドライブ、および 4 台の SAS または SATA ドライブと SATA SSD ① メモ: NVMe ドライブは、PCIe Gen3 の速度に制限されています。 • スレッドあたりの 6 台の SAS または SATA ドライブとは SATA SSD
24 x 2.5 インチ NVMe ドライブ構成	スレッドあたり 6 台の NVMe ドライブ
M.2 SATA ドライブ (オプション)	M.2 SATA カードでサポートされている容量は、最大 960 GB です。 ① メモ: M.2 SATA カードは、M.2 ライザーまたは BOSS カードに取り付けることができます。
起動用マイクロ SD カード (オプション) (最大 64 GB)	ライザー 1a で 1 枚

① **メモ:** NVMe PCIe SSD U.2 デバイスをホットスワップする方法の詳細については、<https://www.dell.com/support> [全製品の閲覧] > [データセンターインフラストラクチャ] > [ストレージアダプターとコントローラー] > [Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD] > [ドキュメント] > [マニュアルとドキュメント] から、『Dell Express Flash NVMe PCIe SSD ユーザーズガイド』を参照してください。

ストレージの仕様

PowerEdge C6520 スレッドは、次をサポートしています。

表 9. システム用のストレージコントローラーカード

内部コントローラ	外部コントローラー
<ul style="list-style-type: none"> • PERC H745 • HBA355i • HBA345 • S150 • H345 • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x M.2 SSD • H350 • H750 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Gbps SAS Ext.HBA

表 10. M.2 SATA ドライブでサポートされている RAID のオプション

オプション	RAID を使用しない 1 台の M.2 SATA ドライブ	ハードウェア RAID を使用するデュアル M.2 SATA ドライブ
ハードウェア RAID	無	有
RAID モード	該当なし	RAID 1、RAID 0
サポートされているドライブ数	1	2

表 10. M.2 SATA ドライブでサポートされている RAID のオプション (続き)

オプション	RAID を使用しない 1 台の M.2 SATA ドライブ	ハードウェア RAID を使用するデュアル M.2 SATA ドライブ
サポートされている CPU	CPU 1	CPU 1

① **メモ:** RAID オプションは、2 台の M.2 SATA ドライブをサポートする BOSS カードでのみサポートされています。

ポートおよびコネクタの仕様

USB ポートの仕様

PowerEdge C6520 スレッドは、システムの背面にある USB 3.0 をサポートします。

ディスプレイ ポートの仕様

PowerEdge C6520 スレッドは、1 x ミニ DisplayPort をサポートします。

NIC ポートの仕様

PowerEdge C6520 スレッドでは、Open Compute Project (OCP) の LAN on Motherboard (LOM) に組み込まれ、オプションの OCP カードに内蔵された 10/100/1000 Mbps ネットワーク インターフェイス コントローラー (NIC) ポートを最大 2 個サポートします。

表 11. スレッドの NIC ポートの仕様

特長	仕様
LOM カード	1 GbE
OCP 3.0 カード	4 x 1 GbE、2 x 10 GbE、2 x 25 GbE、4 x 25 GbE

iDRAC9 ポートの仕様

PowerEdge C6520 スレッドは、システムの背面にある 1 x iDRAC ダイレクト ポート (Micro-AB USB) をサポートします。

ビデオの仕様

PowerEdge C6520 システムは、16 MB のビデオ フレーム バッファを備えた内蔵 Matrox G200 グラフィックス コントローラをサポートします。

表 12. システムでサポートされている前面ビデオ解像度のオプション

解像度	リフレッシュ レート (Hz)	色深度 (ビット)
1024 x 768	60	8、16、32
1280 x 800	60	8、16、32
1280 x 1024	60	8、16、32
1360 x 768	60	8、16、32
1440 x 900	60	8、16、32
1600 x 900	60	8、16、32
1600 x 1200	60	8、16、32

表 12. システムでサポートされている前面ビデオ解像度のオプション（続き）

解像度	リフレッシュレート (Hz)	色深度 (ビット)
1680 x 1050	60	8、16、32
1920 x 1080	60	8、16、32
1920 x 1200	60	8、16、32

環境仕様

① **メモ:** 環境証明の詳細については、www.dell.com/support/home のドキュメントにある「製品環境データシート」を参照してください。

表 13. 動作環境範囲カテゴリ A3

温度	仕様
許容可能な継続動作	
高度 <= 900 m (<= 2,953 ft) の温度範囲	5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)、装置への直射日光なし
湿度範囲 (常に結露なし)	8% RH で最低露点 -12°C ~ 85% RH で最大露点 24°C (75.2°F)
動作高度減定格	900 m (2953 フィート) を越える高度では、最高温度は 175 m ごとに 1°C (574 フィートごとに 33.8°F) 低くなります。

表 14. すべてのカテゴリに共通する要件

温度	仕様
許容可能な継続動作	
最大温度勾配 (動作時と非動作時の両方に適用)	1 時間で 20°C* (1 時間で 36°F)、15 分間で 5°C (15 分間で 41°F)、テープの場合は 1 時間で 5°C* (1 時間で 41°F) ① メモ: * : テープハードウェアの ASHRAE 温度ガイドラインにより、これらは温度変化の瞬間レートではありません。
非動作時の温度制限	-40 ~ 65°C (-104 ~ 149°F)
非動作時の湿度制限	5% ~ 95% RH で最大露点 27°C (80.6°F)
非動作時の最大高度	12,000 メートル (39,370 フィート)
動作時の最大高度	3,048 メートル (10,000 フィート)

最大振動の仕様

表 15. 最大振動の仕様

最大耐久震度	仕様
動作時	0.26 Grms (5 ~ 350 Hz) (全稼働方向)。
ストレージ	1.88 Grms (10 ~ 500 Hz) で 15 分間 (全 6 面で検証済)。

最大衝撃パルス仕様

表 16. 最大衝撃の仕様

最大耐久衝撃	仕様
動作時	x、y、z 軸の正および負方向に 6 G の衝撃パルスを連続して 6 回、11 ミリ秒以下 (システムの各面に対して 4 パルス)。
ストレージ	x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス (システムの各面に対して 1 パルス)、2 ミリ秒以下で 71 G。

粒子状およびガス状汚染物質の仕様

次の表は、粒子汚染およびガス状汚染物による IT 装置の損傷または故障またはその両方を避けるために役立つ制限事項を定義しています。粒子汚染またはガス汚染のレベルが指定された制限を超え、機器の損傷または故障の原因となる場合、環境条件の変更が必要になります。環境状態の修復は、お客様の責任となります。

表 17. 粒子状汚染物質の仕様

粒子汚染	仕様
空気清浄	<p>データセンターの空気清浄レベルは、ISO 14644-1 の ISO クラス 8 の定義に準じて、95% 上限信頼限界です。</p> <p>① メモ: この条件はデータセンターの環境にのみ適用されます。空気清浄要件は、事務所や工場現場などのデータセンター外での使用のために設計された IT 装置には適用されません。</p> <p>② メモ: データセンターに吸入される空気は、MERV11 または MERV13 フィルタで濾過する必要があります。</p>
伝導性ダスト	<p>空気中に伝導性ダスト、亜鉛ウィスカ、またはその他伝導性粒子が存在しないようにする必要があります。</p> <p>① メモ: この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。</p>
腐食性ダスト	<ul style="list-style-type: none"> 空気中に腐食性ダストが存在しないようにする必要があります。 空気中の残留ダストは、潮解点が相対湿度 60% 未満である必要があります。 <p>① メモ: この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。</p>

表 18. ガス状汚染物質の仕様

ガス状汚染物	仕様
銅クーボン腐食度	クラス G1 (ANSI/ISA71.04-2013 の定義による) に準じ、ひと月あたり 300 Å 未満。
銀クーボン腐食度	ANSI/ISA71.04-2013 の定義に準じ、ひと月あたり 200 Å 未満

① メモ: 50% 以下の相対湿度で測定された最大腐食汚染レベル

温度制限

- ① メモ:**
1. 使用不可：設定が Dell EMC によって提供されていないことを示します。

2. 非対応：設定の温度条件がサポートされていないことを示します。

- ① **メモ:** 周囲温度がこれらの表に記載されている連続稼働時最高温度以下である場合、DIMM、通信カード、M.2 SATA、および PERC カードを含むすべてのコンポーネントは、十分な熱マージンでサポートすることができます。
- ① **メモ:** システム ハードウェアの構成によっては、温度上限を下げる必要があります。動作時温度の要件の詳細については、テクニカル サポートにお問い合わせください。
- ① **メモ:** 一部の構成では、周囲温度を低くする必要があります。詳細については、次の表を参照してください。

次の表は、システムに構成された CPU に基づく周囲温度の主な制限を一覧表示しています。次に記載されているすべての吸込温度は、常に摂氏です。

表 19. 2.5 インチ ダイレクト/2.5 インチ NVMe ドライブ構成でのデュアル プロセッサの連続稼働時最高温度 - エア冷却

プロセッサ	TDP (W)	コア	6x ドライブ/ スレッド	4x ドライブ/ スレッド	2x ドライブ/ スレッド	1x ドライブ/ スレッド	BP なし
8380	270	40	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
8368	270	38	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
8368Q	270	38	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
8362	265 W	32	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
8360Y	250	36	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
8358	250	32	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
8358P	240	32	非対応	非対応	非対応	非対応	20
6348	235	28	非対応	非対応	非対応	非対応	20
6342	230	24	非対応	非対応	非対応	20	20
8352Y	205	32	20	20	25	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25	25
6338	205	32	20	20	25	25	25
6330	205	28	20	20	25	25	25
6354	205	18	非対応	20	20	20	25
6346	205	16	非対応	20	20	20	25
8352V	195	36	20	20	25	25	25
8352M	185	32	20*	20*	25	25	25
6338N	185	32	20*	20*	25	25	25
5320	185	26	20*	20*	25	25	25
6336Y	185	24	20*	20*	25	25	25
6326	185	16	20*	20*	25	25	25
6330N	165	28	25	25*	25*	25*	25*
6338T	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318Y	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318S	165	24	25	25*	25*	25*	25*
6334	165	8	25	25*	25*	25*	25*
5318N	150	24	25*	30	30	30	30*
5320T	150	20	25*	30	30	30	30*

表 19. 2.5 インチ ダイレクト/2.5 インチ NVMe ドライブ構成でのデュアル プロセッサの連続稼働時最高温度 - エア冷却 (続き)

プロセッサ	TDP (W)	コア	6 x ドライブ/ スレッド	4 x ドライブ/ スレッド	2 x ドライブ/ スレッド	1 x ドライブ/ スレッド	BP なし
4316	150	20	25*	30	30	30	30*
5317	150	12	25*	30	30	30	30*
5315Y	140	8	30	30	30*	30*	30*
4314	135	16	30*	30*	30*	30*	30*
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

メモ:

- *マーク付きのデータは、この構成において HSK で拡張プロセッサ 1 を使用している場合、+5°C で温度オフセットがあることを意味します。
- H745 はプロセッサ TDP > 185 W でサポートされていません。
- PCIE > 25 W、128GB の LRDIMM および GPU の構成には、追加の熱制限が必要です。

表 20. プロセッサ 1 の 2.5 インチ ダイレクト ドライブ構成におけるシングル プロセッサの連続稼働時最高温度 - エア冷却

プロセッサ	TDP (W)	コア	6 x ドライブ/ スレッド	4 x ドライブ/ スレッド	2 x ドライブ/ スレッド	1 x ドライブ/ スレッド	BP なし
8380	270	40	20	20	20	20	25
8368	270	38	20	20	25	25	25
8368Q	270	38	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
8362	265 W	32	20	20	25	25	25
8360Y	250	36	20	20	25	25	25
8358	250	32	20	20	25	25	25
8358P	240	32	20	20	25	25	25
6348	235	28	25	25	25	25	30
6342	230	24	25	25	25	25	30
8351N	225	36	20	20	25	25	25
8352Y	205	32	30	30	35	35	35
6314U	205	32	30	30	35	35	35
8352S	205	32	30	30	35	35	35
6338	205	32	30	30	35	35	35
6330	205	28	30	30	35	35	35
6354	205	18	25	25	30	30	30
6346	205	16	25	25	30	30	30
8352V	195	36	30	30	30	30	35
8352M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35

表 20. プロセッサ 1 の 2.5 インチ ダイレクト ドライブ構成におけるシングルプロセッサの連続稼働時最高温度 - エア冷却 (続き)

プロセッサ	TDP (W)	コア	6x ドライブ/ スレッド	4x ドライブ/ スレッド	2x ドライブ/ スレッド	1x ドライブ/ スレッド	BP なし
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6312U	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

①メモ: PCIE > 25 W、128GB の LRDIMM および GPU の構成には、追加の熱制限が必要です。

表 21. 2.5 インチ ピュア NVMe ドライブ構成でのデュアルプロセッサの連続稼働時最高温度 - エア冷却

プロセッサ	TDP (W)	コア	6x ドライブ/ スレッド	4x ドライブ/ スレッド	2x ドライブ/ スレッド	1x ドライブ/ スレッド
8380	270	40	非対応	非対応	非対応	非対応
8368	270	38	非対応	非対応	非対応	非対応
8368Q	270	38	非対応	非対応	非対応	非対応
8362	265 W	32	非対応	非対応	非対応	非対応
8360Y	250	36	非対応	非対応	非対応	非対応
8358	250	32	非対応	非対応	非対応	非対応
8358P	240	32	非対応	非対応	非対応	非対応
6348	235	28	非対応	非対応	非対応	非対応
6342	230	24	非対応	非対応	非対応	20
8352Y	205	32	20	20	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25
6338	205	32	20	20	25	25
6330	205	28	20	20	25	25
6354	205	18	非対応	非対応	20	20
6346	205	16	非対応	非対応	20	20

表 21. 2.5 インチ ピュア NVMe ドライブ構成でのデュアルプロセッサの連続稼働時最高温度 - エア冷却 (続き)

プロセッサ	TDP (W)	コア	6 x ドライブ/スレ ッド	4 x ドライブ/スレ ッド	2 x ドライブ/スレ ッド	1 x ドライブ/ス レッド
8352V	195	36	20	20	25	25
8352M	185	32	20	20	25	25
6338N	185	32	20	20	25	25
5320	185	26	20	20	25	25
6336Y	185	24	20	20	25	25
6326	185	16	20	20	25	25
6330N	165	28	20*	20*	25*	25*
6338T	165	24	20*	20*	25*	25*
5318Y	165	24	20*	20*	25*	25*
5318S	165	24	20*	20*	25*	25*
6334	165	8	20*	20*	25*	25*
5318N	150	24	25	25	30	30
5320T	150	20	25	25	30	30
4316	150	20	25	25	30	30
5317	150	12	25	25	30	30
5315Y	140	8	25*	25*	30*	30*
4314	135	16	25*	25*	30*	30*
4310	120	12	30	30	35	35
4310T	105	10	30*	30*	35	35
4309Y	105	8	30*	30*	35	35

表 22. 3.5 インチ ダイレクト ドライブ構成でのデュアルプロセッサの連続稼働時最高温度 - エア冷却

プロセッサ	TDP (W)	コア	3 x ドライブ/スレ ッド	2 x ドライブ/スレ ッド	1 x ドライブ/スレ ッド
8380	270	40	非対応	非対応	非対応
8368	270	38	非対応	非対応	非対応
8368Q	270	38	非対応	非対応	非対応
8362	265 W	32	非対応	非対応	非対応
8360Y	250	36	非対応	非対応	非対応
8358	250	32	非対応	非対応	非対応
8358P	240	32	非対応	非対応	非対応
6348	235	28	非対応	非対応	非対応
6342	230	24	非対応	非対応	非対応
8351N	225	36	非対応	非対応	非対応
8352Y	205	32	非対応	非対応	非対応
6314U	205	32	非対応	非対応	非対応
8352S	205	32	非対応	非対応	非対応
6338	205	32	非対応	非対応	非対応

表 22. 3.5 インチ ダイレクト ドライブ構成でのデュアル プロセッサの連続稼働時最高温度 - エア冷却 (続き)

プロセッサ	TDP (W)	コア	3×ドライブ/スレ ド	2×ドライブ/スレ ッド	1×ドライブ/スレ ッド
6330	205	28	非対応	非対応	非対応
6354	205	18	非対応	非対応	非対応
6346	205	16	非対応	非対応	非対応
8352V	195	36	非対応	非対応	非対応
8352M	185	32	非対応	非対応	非対応
6338N	185	32	非対応	非対応	非対応
5320	185	26	非対応	非対応	非対応
6336Y	185	24	非対応	非対応	非対応
6312U	185	24	非対応	非対応	非対応
6326	185	16	非対応	非対応	非対応
6330N	165	28	非対応	非対応	20
6338T	165	24	非対応	非対応	20
5318Y	165	24	非対応	非対応	20
5318S	165	24	非対応	非対応	20
6334	165	8	非対応	非対応	20
5318N	150	24	非対応	非対応	20
5320T	150	20	非対応	非対応	20
4316	150	20	非対応	非対応	20
5317	150	12	非対応	非対応	20
5315Y	140	8	非対応	20	20*
4314	135	16	非対応	20*	20*
4310	120	12	20	25	25
4310T	105	10	25	30	30
4309Y	105	8	25	30	30

表 23. 3.5 インチ ダイレクト ドライブ構成でのシングル プロセッサの連続稼働時最高温度 - エア冷却

プロセッサ	TDP (W)	コア	3×ドライブ/スレ ド	2×ドライブ/スレ ッド	1×ドライブ/スレ ッド
8380	270	40	非対応	非対応	非対応
8368	270	38	非対応	非対応	非対応
8368Q	270	38	非対応	非対応	非対応
8362	265 W	32	非対応	非対応	非対応
8360Y	250	36	非対応	非対応	非対応
8358	250	32	非対応	非対応	非対応
8358P	240	32	非対応	非対応	20
6348	235	28	非対応	20	20
6342	230	24	非対応	20	20
8351N	225	36	非対応	非対応	20

表 23. 3.5 インチ ダイレクト ドライブ構成でのシングル プロセッサの連続稼働時最高温度 - エア冷却 (続き)

プロセッサ	TDP (W)	コア	3 × ドライブ/スレド	2 × ドライブ/スレド	1 × ドライブ/スレド
8352Y	205	32	20	25	25
6314U	205	32	20	25	25
8352S	205	32	20	25	25
6338	205	32	20	25	25
6330	205	28	20	25	25
6354	205	18	非対応	20	25
6346	205	16	非対応	20	25
8352V	195	36	20	25	25
8352M	185	32	25	30	30
6338N	185	32	25	30	30
5320	185	26	25	30	30
6336Y	185	24	25	30	30
6312U	185	24	25	30	30
6326	185	16	25	30	30
6330N	165	28	25	30	30
6338T	165	24	25	30	30
5318Y	165	24	25	30	30
5318S	165	24	25	30	30
6334	165	8	25	30	30
5318N	150	24	30	35	35
5320T	150	20	30	35	35
4316	150	20	30	35	35
5317	150	12	30	35	35
5315Y	140	8	30	35	35
4314	135	16	30	35	35
4310	120	12	30	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

表 24. 2.5 インチ ダイレクト/2.5 インチ NVMe ドライブ構成でのデュアル プロセッサの連続稼働時最高温度 - 液体冷却

プロセッサ	TDP (W)	コア	6 × ドライブ/スレド	4 × ドライブ/スレド	2 × ドライブ/スレド	1 × ドライブ/スレド	BP なし
8380	270	40	35	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35	35	35
8362	265 W	32	35	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35	35

表 24. 2.5 インチ ダイレクト/2.5 インチ NVMe ドライブ構成でのデュアル プロセッサの連続稼働時最高温度 - 液体冷却 (続き)

プロセッサ	TDP (W)	コア	6 x ドライブ/ スレッド	4 x ドライブ/ スレッド	2 x ドライブ/ スレッド	1 x ドライブ/ スレッド	BP なし
8358	250	32	35	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

①メモ: PCIe > 25 W、128GB の LRDIMM および GPU の構成には、追加の熱制限が必要です。

表 25. 2.5 インチ ピュア NVMe ドライブ構成でのデュアル プロセッサの連続稼働時最高温度 - 液体冷却

プロセッサ	TDP (W)	コア	6 x ドライブ/ スレッド	4 x ドライ ブ/スレッド	2 x ドライ ブ/スレッド	1 x ドライブ/ スレッド
8380	270	40	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35

表 25. 2.5 インチ ピュア NVMe ドライブ構成でのデュアル プロセッサの連続稼働時最高温度 - 液体冷却 (続き)

プロセッサ	TDP (W)	コア	6x ドライブ/ スレッド	4x ドライ ブ/スレッド	2x ドライ ブ/スレッド	1x ドライブ/スレッド
8368Q	270	38	35	35	35	35
8362	265 W	32	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35

①メモ: PCIE > 25 W、128GB の LRDIMM および GPU の構成には、追加の熱制限が必要です。

表 26. 3.5 インチ ダイレクト ドライブ構成でのデュアル プロセッサの連続稼働時最高温度 - 液体冷却

プロセッサ	TDP (W)	コア	3 × ドライブ/スレド	2 × ドライブ/スレド	1 × ドライブ/スレド
8380	270	40	35	35	35
8368	270	38	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35
8362	265 W	32	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35
8358	250	32	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35
6348	235	28	35	35	35
6342	230	24	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35
6338	205	32	35	35	35
6330	205	28	35	35	35
6354	205	18	35	35	35
6346	205	16	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35
5320	185	26	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35
6326	185	16	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35
6334	165	8	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35
4316	150	20	35	35	35
5317	150	12	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35
4314	135	16	35	35	35
4310	120	12	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

📌 **メモ:** PCIe > 25 W、128GB の LRDIMM および GPU の構成には、追加の熱制限が必要です。

ASHRAE A3 の構成に関する制限事項

表 27. ASHRAE A3 の構成に関する制限事項

液体冷却	エア冷却
<ul style="list-style-type: none">● NVMe SSD はサポートされていません。● LRDIMM はサポートされていません。● 25 W を超える PCIe カードはサポートされていません。● GPU カードはサポートされていません。● 3.5 インチ ドライブの構成はサポートされていません。	<ul style="list-style-type: none">● NVMe SSD はサポートされていません。● LRDIMM はサポートされていません。● 25W を超える PCIe カードはサポートされていません。● GPU カードはサポートされていません。● 3.5 インチ ドライブの構成はサポートされていません。● 1P スレッドの場合、サポートされている最大の CPU TDP は 150 W です。● 2P スレッドの場合、サポートされている最大の CPU TDP は 105 W です。